

南茂科技股份有限公司

大學院校學生實習合作計畫

一、目的：

為藉由學界技術與產業實務交流，強化優秀學子致力於半導體測試封裝領域相關學術研究與技術創新，南茂科技股份有限公司（下稱「南茂」）特設立本實習合作計畫。

二、合作對象：中原大學機械工程學系、化學工程學系、資訊工程學系、資訊管理學系、半導體材料與光電檢測碩士學位學程

三、申請資格：下列兩者條件擇一

1. 大三升大四生、大四升碩一生(繼續就讀中原大學研究所)及碩士班在學學生或系所專案推薦之學生。
2. 申請南茂獎助學金之學生。

四、申請期間：

自 2025 年 4 月 14 日起至 2025 年 5 月 2 日止，並於 2025 年 6 月 9 日通知審核結果。

五、申請方式：

1. 符合條件之申請者，應檢附書面資料如下：
 - (1) 填寫申請表一份暨檢附身分證與學生證影本並黏貼於申請表
 - (2) 申請全學年之成績單正本、獎懲證明，影本須加蓋教務處章

六、實習內容：

- 期間：於 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 8 月 29 日暑假期間，至南茂廠區進行實務工作實習二個月，接受部門職務技能訓練。
- 職缺：

學生實習部門與職務內容以南茂公告開放職缺為主。本公司得依公司整體發展方向及業務需求，參酌學生的專長與意願進行任職單位分發，非有不可抗力之因素，學生應接受分發結果。如因對工作之地域有特殊需求之學生，可於申請表表明工作地域之需求。
- 地點：竹北一廠、竹科一廠

七、薪資福利：

- 薪資：給予優於法定基本工資之薪資水準。
- 工時：週一~週五 08:30~17:30 常日班制
- 休假：依公司人事規章辦法規定
- 福利：
 1. 享有勞保/健保/團保(限本人)
 2. 享有勞退新制退休金
 3. 享有福委會各項福利
 4. 享有員工餐廳用餐補助
 5. 享有與正職人員相同之內部專業訓練

八、審查方式：

開放進行報名後，由南茂進行資格初選及面談與核定。